

日月光一〇二年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 102 年 4 月 26 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇二年度第一季獲利報告，本公司一〇二年第一季之合併營業收入較一〇一年第四季衰退 14%，較一〇一年同期成長 12%，為新台幣 48,190 百萬元。茲將日月光一〇二年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

簡明日月光集團合併營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	102 年度 第一季	101 年度 第四季	101 年度 第一季
營業收入	48,190	56,008	43,101
營業毛利	8,281	10,975	7,180
營業淨利(淨損)	3,603	5,933	2,815
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	3,159	5,815	2,573
所得稅利益(費用)	(803)	(1,288)	(465)
非控制權益純損(益)	(125)	(154)	(62)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	2,231	4,373	2,046
稀釋每股盈餘(元)	0.29	0.58	0.27

簡明日月光半導體封裝測試營運分析表

單位：新台幣百萬元

項 目	102 年度 第一季	101 年度 第四季	101 年度 第一季
營業收入	31,317	34,395	29,236
營業毛利	6,224	7,972	5,621
營業淨利(淨損)	2,669	4,197	2,370
繼續營業部門稅前淨利(淨損)	2,776	4,973	2,412
所得稅利益(費用)	(506)	(556)	(355)
非控制權益純損(益)	(39)	(44)	(11)
本期歸屬予母公司股東淨利(淨損)	2,231	4,373	2,046
稀釋每股盈餘(元)	0.29	0.58	0.27

半導體封裝測試營運

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	52
個人電腦	11
汽車及消費性電子產品	36
其他	1
前十大客戶佔營收比重	49

銷 售 地 區	占營收比率(%)
北美	60
歐洲	11
台灣	17
日本	6
亞洲其他地區	6

封 裝 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
Advanced Packaging	26
IC Wirebonding	63
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	69 百萬美元
打線機台數	15,559 台

測 試 業 務 產 品 組 合	占營收比率(%)
後段測試	78
晶圓測試	19
前段測試	3
測試資本支出金額	40 百萬美元
測試機台數	2,945 台

電子製造代工服務之產品結構及客戶組成

產 品 結 構	占營收比率(%)
通訊產品	33
電腦產品	28
消費產品	13
工業產品	17
汽車電子產品	8
其他	1
前十大客戶佔營收比重	84
EMS 資本支出金額	5 百萬美元